



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN22980X

Issue Date: 24 Feb 2020

Title of Change:	Qualification of new lead frame with Downset change for NCP3170ADR2G SOIC8	
Proposed First Ship date:	24 Aug 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Bob.Sy@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Changed product will be identified by datecode.	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Carmona, Philippines	None	
Description and Purpose:		
Change in package leadframe. There is no change in the exterior form, fit, or function of the product.		
	Before Change Description	After Change Description
LeadFrame	H00976A537 with LF DS, 8mils +/-1.5mil	H00976A539 (engineering) New LF with No LF downset
There is no product marking change as a result of this change.		



Qualification Plan:

QV DEVICE NAME NCP3710ADR2G

PACKAGE SOIC 8 MCM

Test	Specification	Condition	Interval
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260 °C	

Estimated date for qualification completion: 8 May 2020

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
NCP3170ADR2G	NCP3170ADR2G
NCP3170BDR2G	NCP3170ADR2G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22980X

発行日: 24 Feb 2020

変更件名:	NCP3170ADR2G SOIC8 用 ダウンセット変更の新規リードフレームの変更	
初回出荷予定日:	24 August 2020 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Bob.Sy@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	変更された製品は、日付コードによって識別されます。	
変更カテゴリ:	アセンブリの変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Carmona, Philippines	なし	
説明および目的:	パッケージ・リードフレームの変更。製品の外觀形状、適合性、機能に変更はありません。	
	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	H00976A537 with LF DS, 8mils +/-1.5mil	H00976A539 (engineering) New LF with No LF downset
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



認定計画:

デバイス名: NCP3710ADR2G

RMS 63878

パッケージ: SOIC 8 MCM

テスト	規格	条件	間隔
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260 °C	

認定完了予定日: 8 May 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NCP3170ADR2G	NCP3170ADR2G
NCP3170BDR2G	NCP3170ADR2G



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
NCP3170BDR2G		NCP3170ADR2G		
NCP3170ADR2G		NCP3170ADR2G		